

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム (SenTePack)

第2回研究会 プログラム

- 1、開催日時：2025 年 9 月 26 日(金) 13：00~16：35
- 2、開催方式：会場/Online（ハイブリッド開催）
- 3、開催会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11 階 第1会議室
- 4、会場アクセス：<https://www.aist.go.jp/waterfront/ja/access/index.html>
- 5、プログラム：

13：00~13：10 開会挨拶 SenTePack 会長 植村 聖

13：10~13：50 WG 活動報告

- ・センシング材料 WG
- ・環境モニタリング技術 WG
- ・人・機械インタラクション WG
- ・半導体製造センシング・実装技術 WG

14：00~15：00

講演1「来る Smart Home2.0 の時代を形つくるテクノロジー」

X-HEMISTRY 株式会社 FOUNDER & CEO 新貝 文将 様

概要：日本でもいよいよスマートホームの本格的な普及が始まりつつあり、その基盤として世界的に注目を集めているのがスマートホームのグローバル共通規格「Matter」です。本講演では、Matter の概要に加え、今後のスマートホームをさらに発展させ「Smart Home2.0」へと導く鍵となるテクノロジーをいくつか取り上げます。

15：00~15：30 コーヒーブレイク（名刺交換・意見交換）

15：30~16：30

講演2「光ディスアグリゲートドコンピュータの研究開発状況」

NTT 先端集積デバイス研究所 主任研究員 有川 勇輝 様

概要：NTT は、IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) 構想の実現をめざし、光電融合技術を活用するディスアグリゲートドコンピュータの研究開発を進めています。本講演では、要素技術を中心に NTT 研究所の研究開発事例を紹介いたします。

16：30~16：35 研究会 閉会挨拶 SenTePack 副会長 吉田 学

お問い合わせ先：

SenTePack 事務局

国立研究開発法人産業技術総合研究所センシング技術研究部門

e-mail：M-SenTePack-ml@aist.go.jp